场效应管

场效应管

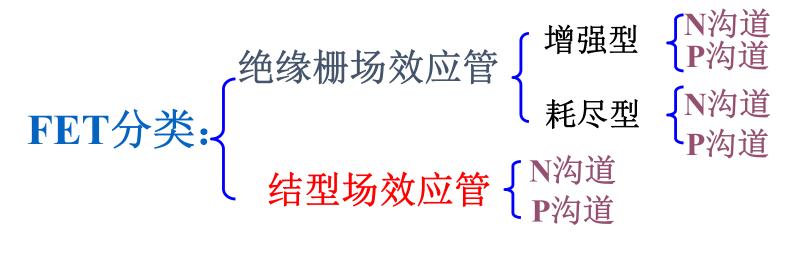
- 绝缘栅场效应管
- 结型场效应管

3.1 场效应管

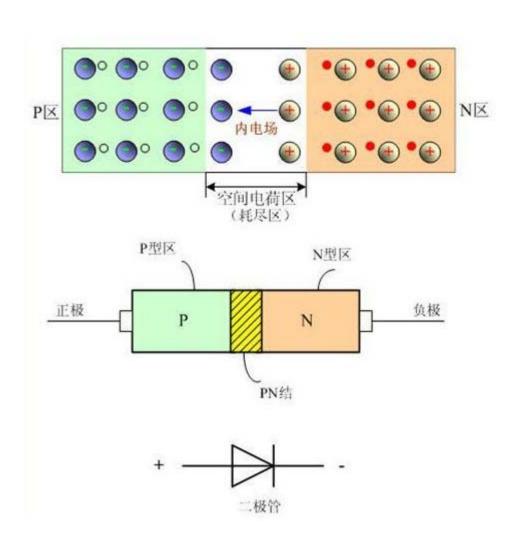
双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor-BJT)的缩写。BJT是一种电流控制元件($i_{B}\sim i_{C}$),工作时,多数载流子和少数载流子都参与运行,所以被称为双极型器件。

场效应管(Field Effect Transistor简称FET)是一种电压控制器件($u_{GS} \sim i_D$),工作时,只有一种载流子参与导电,因此它是单极型器件。

FET因其制造工艺简单,功耗小,温度特性好,输入电阻极高等优点,得到了广泛应用。

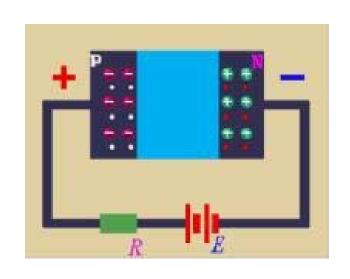


PN结的工作原理



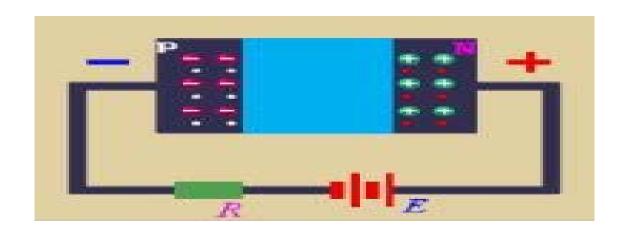
(1) PN结加正向电压时的导电情况

在外电场作用下,多子将向PN结移动,结果使空间电荷区变窄,内电场被削弱,有利于多子的扩散而不利于少子的漂移,扩散运动起主要作用。结果,P区的多子空穴将源源不断的流向N区,而N区的多子自由电子亦不断流向P区,这两股载流子的流动就形成了PN结的正向电流。PN结呈现低阻性。

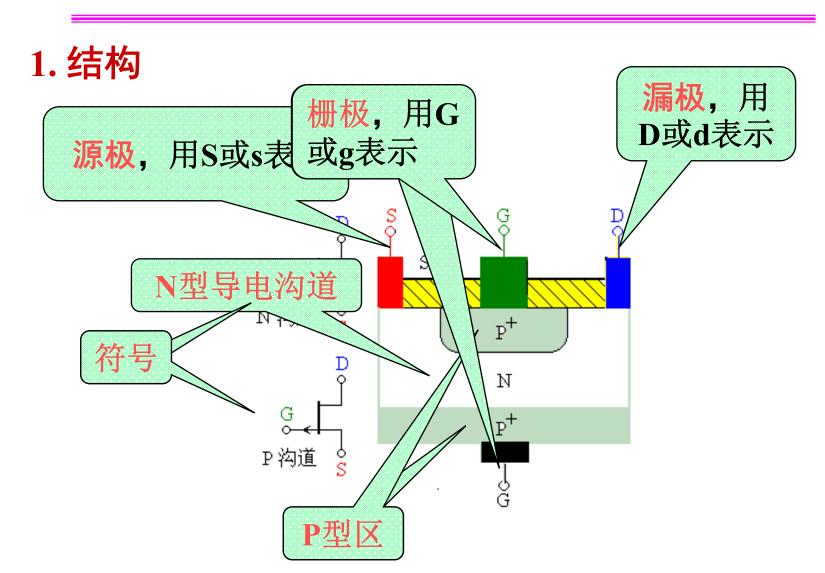


(2) PN结加反向电压时的导电情况

在外电场作用下,多子将背离PN结移动,结果使空间电荷区变宽,内电场被增强,有利于少子的漂移而不利于多子的扩散,漂移运动起主要作用。漂移运动产生的漂移电流的方向与正向电流相反,称为反向电流,PN结呈现高阻性。



JFET的结构和工作原理



??? 符号中的箭头方向表示什么?

二.结型场效应管

1. 结型场效应管的结构(以N沟为例):

两个PN结夹着一个N型沟道。

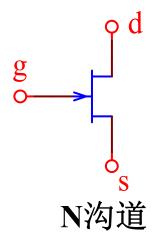
三个电极:

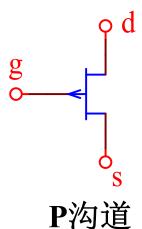
g: 栅极

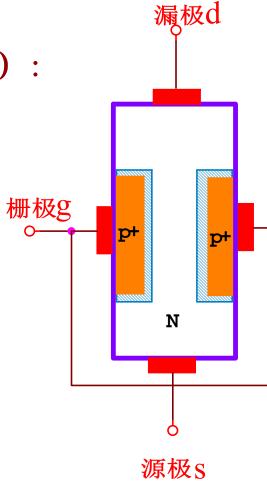
d: 漏极

s: 源极

符号:







2. 结型场效应管的工作原理

(1) 栅源电压对沟道的控制作用

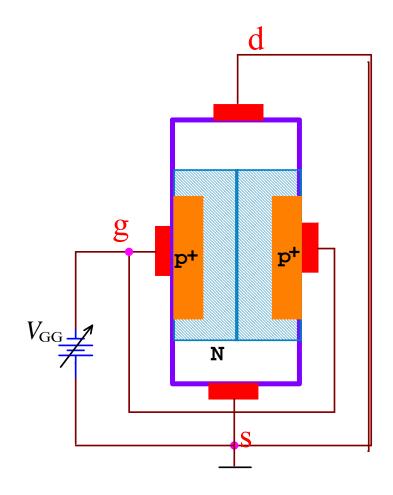
在栅源间加负电压 u_{GS} ,令 $u_{DS}=0$

①当 u_{GS} =0时,为平衡PN结,导电沟道最宽

- ②当 u_{GS} | ↑时,PN结反偏,耗尽层变宽,导电沟道变窄,沟道电阻增大。
- ③当 $|u_{GS}|$ ↑到一定值时,沟道会完全合拢。

定义:

夹断电压 U_P —使导电沟道完全合拢(消失)所需要的栅源电压 u_{GS} 。

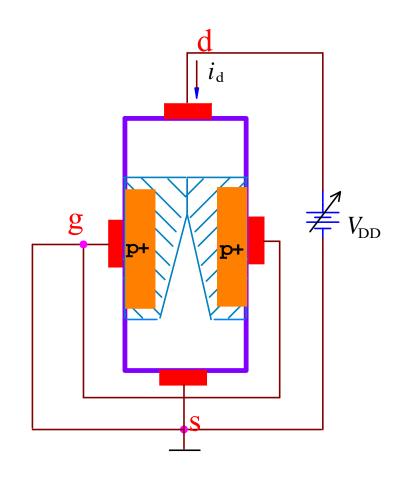


(2)漏源电压对沟道的控制作用

在漏源间加电压 u_{DS} ,令 $u_{GS}=0$ 由于 $u_{GS}=0$,所以导电沟道最宽。

- ①当 $u_{\rm DS}$ =0时, $i_{\rm D}$ =0。
- $2u_{DS}\uparrow \rightarrow i_{D}\uparrow$ \rightarrow 靠近漏极处的耗尽层加宽, 沟道变窄,呈楔形分布。
- ③当 $u_{\rm DS}$ ↑,使 $u_{\rm GD}$ = $u_{\rm GS}$ - $u_{\rm DS}$ = $U_{\rm P}$ 时,在靠漏极处夹断——预夹断。
- $(u_{DS}$ 再 \uparrow , 预夹断点下移。

预夹断前, $u_{\mathrm{DS}} \uparrow \rightarrow i_{\mathrm{D}} \uparrow$ 。 预夹断后, $i_{\mathrm{DS}} \uparrow \rightarrow i_{\mathrm{D}}$ 几乎不变。

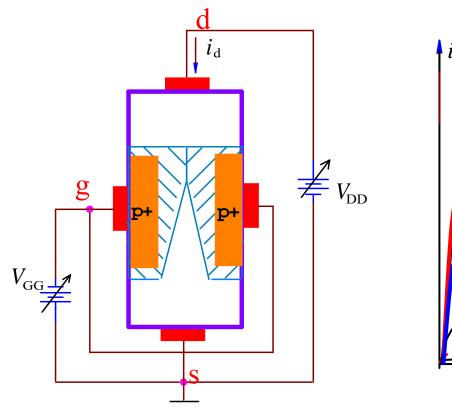


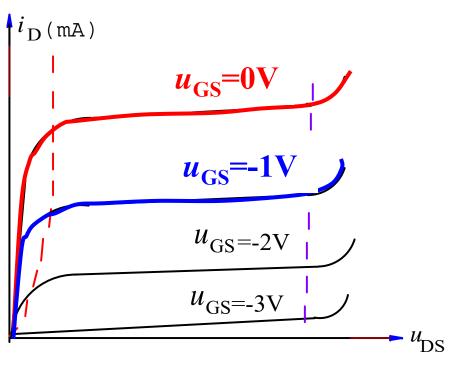
(3) 栅源电压 u_{GS} 和漏源电压 u_{DS} 共同作用

 $i_{D} = f(u_{GS}, u_{DS})$,可用输两组特性曲线来描绘。

3、 结型场效应三极管的特性曲线

(1) 输出特性曲线: $i_D = f(u_{DS})$ $u_{cs} = 常数$





设: $U_{\rm T}$ =-3V

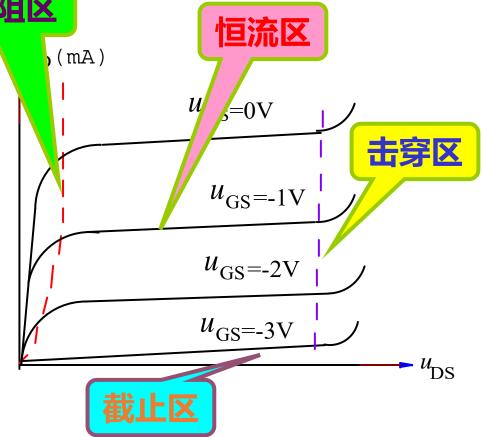
四个区:

- 可变电阻区
- (a) 可变电阻区 (预夹断前)。
- (b) 恒流区也称饱和 区(预夹断后)。

恒流区的特点:

 $\triangle i_{\mathrm{D}}/\triangle u_{\mathrm{GS}} = g_{\mathrm{m}} \approx$ 常数即: $\triangle i_{\mathrm{D}} = g_{\mathrm{m}} \triangle u_{\mathrm{GS}}$ (放大原理)

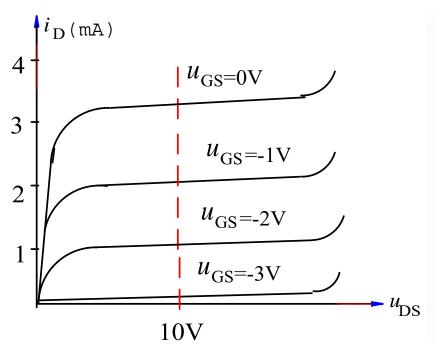
(c) 夹断区 (截止区)。

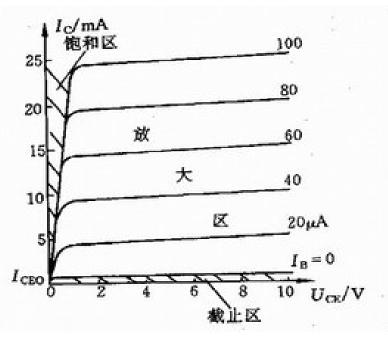


(d) 击穿区。

(2) 转移特性曲线: $i_{\mathbf{D}} = f(u_{\mathbf{GS}}) \mid u_{\mathbf{DS}} = \mathbb{R}$

可根据输出特性曲线作出**移特性曲线**。例:作 u_{DS} =10V的一条**转移特性曲线**:





4.场效应管的主要参数

- (1) 开启电压**U**T
- U_{T} 是MOS增强型管的参数,栅源电压小于开启电压的绝对值,场效应管不能导通。
- (2) 夹断电压 $U_{\rm P}$ $U_{\rm P}$ 是MOS耗尽型和结型FET的参数,当 $u_{\rm GS}$ = $U_{\rm P}$ 时,漏极电流为零。
- (3) 饱和漏极电流 I_{DSS} MOS耗尽型和结型FET, 当 u_{CS} =0时所对应的漏极电流。
 - (4) 输入电阻 $R_{\rm GS}$ 结型场效应管, $R_{\rm GS}$ 大于 $10^7\Omega$, ${
 m MOS}$ 场效应管, $R_{\rm GS}$ 可达 $10^9\sim10^{15}\Omega$ 。
- (5) 低频跨导 $g_{\rm m}$ $g_{\rm m}$ 反映了栅压对漏极电流的控制作用,单位是 ${
 m mS}$ (毫西门子)。
- (6) 最大漏极功耗 $P_{\rm DM}$ $P_{\rm DM} = U_{\rm DS} I_{\rm D}$,与双极型三极管的 $P_{\rm CM}$ 相当。

5.双极型和场效应型三极管的比较

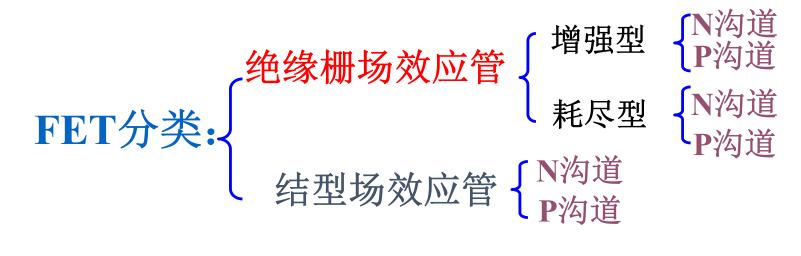
	双极型三极管	单极型场效应管
载流子	多子扩散少子漂移	少子漂移
输入量	电流输入	电压输入
控制	电流控制电流源	电压控制电流源
输入电阻	几十到几千欧	几兆欧以上
噪声	较大	较小
静电影响	不受静电影响	易受静电影响
制造工艺	不宜大规模集成	适宜大规模和超大 规模集成

场效应管

双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor-BJT)的缩写。**BJT**是一种电流控制元件(i_{B} ~ i_{C}),工作时,多数载流子和少数载流子都参与运行,所以被称为双极型器件。

场效应管(Field Effect Transistor简称FET)是一种电压控制器件($u_{GS} \sim i_D$),工作时,只有一种载流子参与导电,因此它是单极型器件。

FET因其制造工艺简单,功耗小,温度特性好,输入电阻极高等优点,得到了广泛应用。



一. 绝缘栅场效应管

绝缘栅型场效应管 (Metal Oxide_Semiconductor FET),

简称MOSFET。分为:

增强型 → N沟道、P沟道

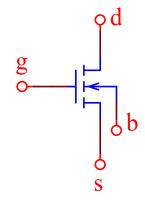
耗尽型 → N沟道、P沟道

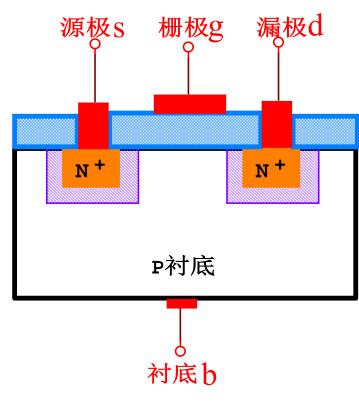
- 1. N沟道增强型MOS管
 - (1) 结构

4个电极:漏极D,

源极S,栅极G和 衬底B。

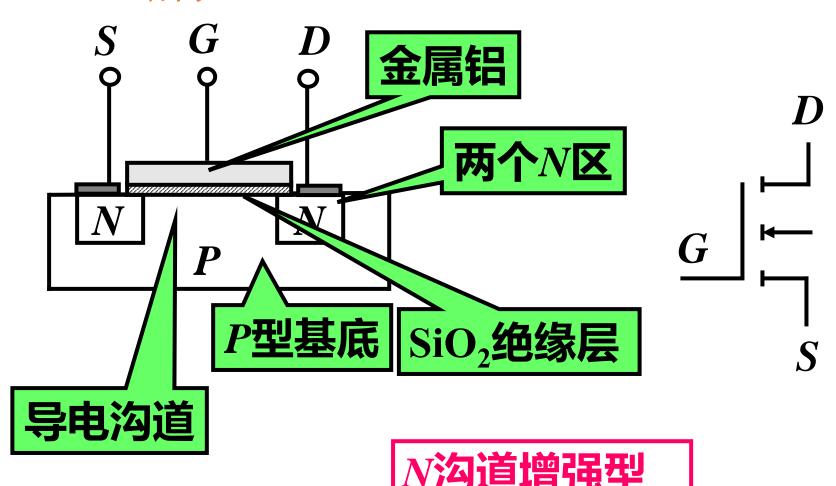
符号:





N沟道增强型MOSFET

1. 结构



(2) 工作原理

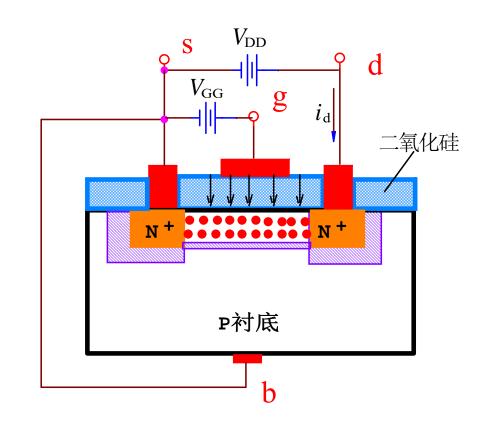
①栅源电压ucs的控制作用

当 u_{GS} =0V时,漏源之间相当两个背靠背的 二极管,在 d、s之间加上电压也不会形成电流,即管子截止。

当u_{GS}>0V时→纵向电场

→将靠近栅极下方的空穴向 下排斥→耗尽层。

再增加u_{GS}→纵向电场↑ →将P区少子电子聚集到 P区表面→形成导电沟道, 如果此时加有漏源电压, 就可以形成漏极电流i_d。



定义:

开启电压(U_{T})——刚刚产生沟道所需的栅源电压 U_{CS} 。

N沟道增强型MOS管的基本特性:

 $u_{GS} < U_{T}$,管子截止,

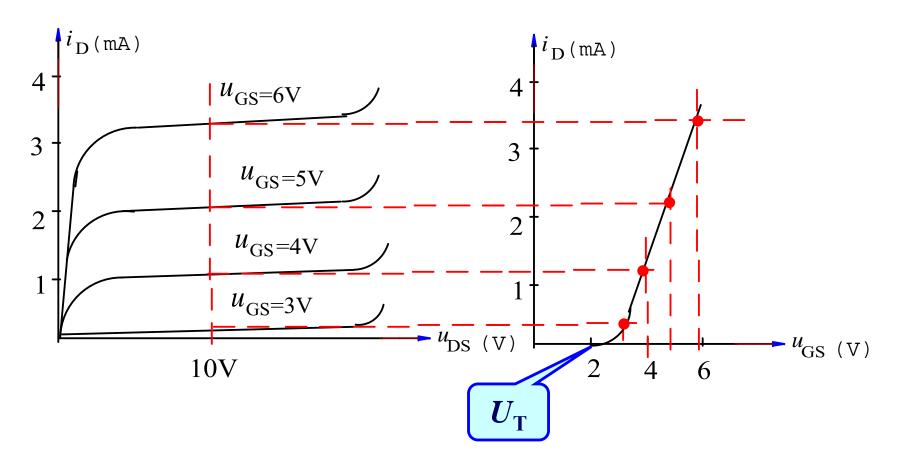
 $u_{\rm GS}>U_{\rm T}$,管子导通。

 u_{GS} 越大,沟道越宽,在相同的漏源电压 u_{DS} 作用下,漏极电流 I_{D} 越大。

②转移特性曲线: $i_D = f(u_{GS}) |_{u_{DS} = const}$

可根据输出特性曲线作出移特性曲线。

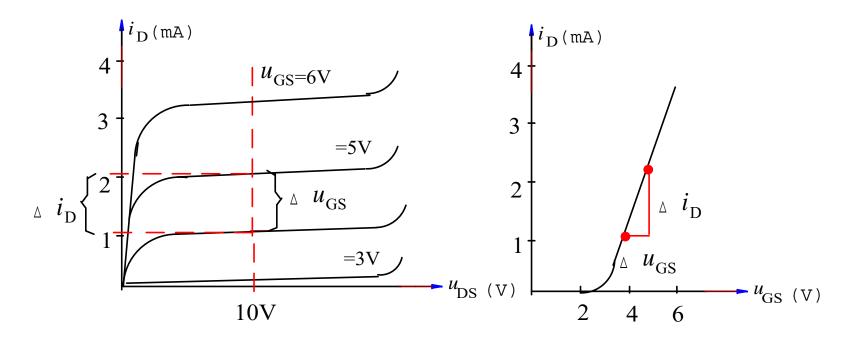
例: $\mu_{DS}=10V$ 的一条转移特性曲线:

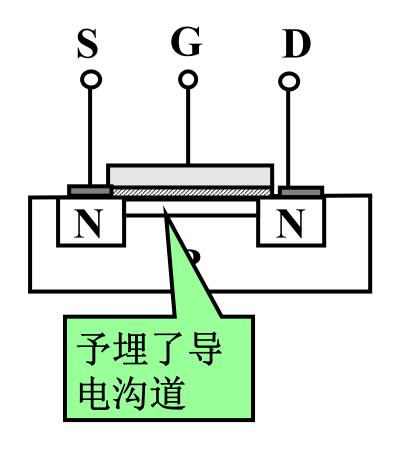


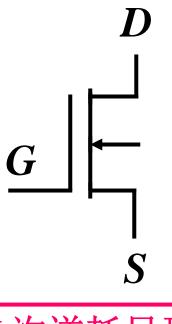
一个重要参数——跨导 g_{m}

$$g_{\rm m} = \Delta i_{\rm D} / \Delta u_{\rm GS} |_{u_{\rm DS} = {\rm const}}$$
 (单位mS)

 $g_{\rm m}$ 的大小反映了栅源电压对漏极电流的控制作用。 在转移特性曲线上, $g_{\rm m}$ 为的曲线的斜率。 在输出特性曲线上也可求出 $g_{\rm m}$ 。







N沟道耗尽型

2.N沟道耗尽型MOSFET

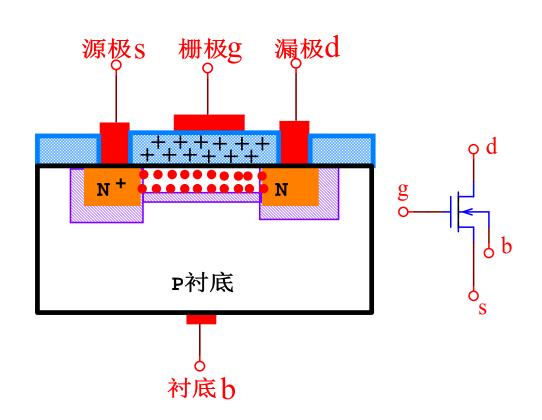
在栅极下方的 SiO_2 层中掺入了大量的金属正离子。所以当 u_{CS} =0时,这些正离子已经感应出反型层,形成了沟道。

特点:

当 u_{GS} =**0**时,就有沟道,加入 u_{DS} ,就有 i_{D} 。

当 $u_{GS}>0$ 时,沟道增宽, i_D 进一步增加。

当 u_{GS} <0时,沟道变窄, i_D 减小。



定义:

夹断电压(U_{P})——沟道刚刚消失所需的栅源电压 u_{GS} 。

3、P沟道耗尽型MOSFET

P沟道MOSFET的工作原理与N沟道

MOSFET完全相同,只不过导电的载流子不同,供电电压极性不同而已。这如同双极型三极管有NPN型和PNP型一样。

4. MOS管的主要参数

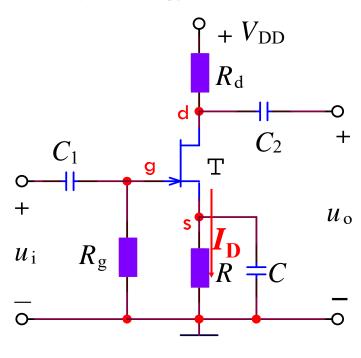
- (1) 开启电压**U**_T
- (2) 夹断电压Up
- (3) 跨导 $g_{\rm m}$: $g_{\rm m} = \Delta i_{\rm D}/\Delta u_{\rm GS}$ $u_{\rm DS} = {\rm const}$
- (4) 直流输入电阻 R_{GS} ——栅源间的等效电阻。由于MOS管栅源间有 sio_2 绝缘层,输入电阻可达 $10^9 \sim 10^{15}$ 。

3.2 场效应管放大电路

一. 直流偏置电路 保证管子工作在饱和区,输出信号不失真

1.自偏压电路

 $U_{GS} = I_D R$



计算Q点: U_{GS} 、 I_{D} 、 U_{DS} 已知 U_{P} ,由

$$\begin{array}{ccc}
 & C_2 & + \\
 & C_2 & + \\
 & U_{GS} = -I_D R \\
 & I_D = I_{DSS} (1 - \frac{U_{GS}}{U_P})^2
\end{array}$$

可解出Q点的 U_{GS} 、 I_{D}

再求:
$$U_{\rm DS} = V_{\rm DD} - I_{\rm D} (R_{\rm d} + R)$$

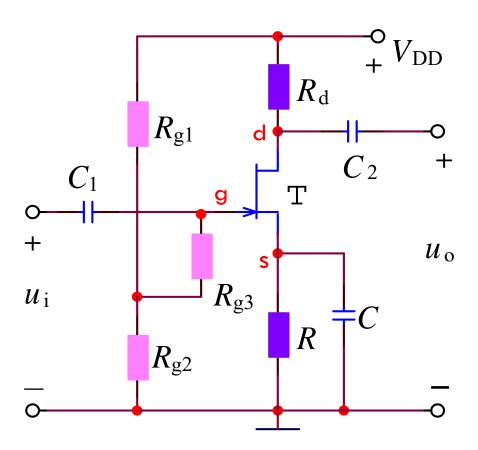
注意: 该电路产生负的栅源电压, 所以只能用于需要负栅源电压的电路。

2.分压式自偏压电路



$$U_{GS} = U_{G} - U_{S}$$

$$= \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - I_{D}R$$



计算Q点:

已知 $U_{\rm P}$,由

$$\begin{cases} U_{GS} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - I_{D}R \\ I_{D} = I_{DSS} (1 - \frac{U_{GS}}{U_{P}})^{2} \end{cases}$$

可解出Q点的 U_{GS} 、 I_{D}

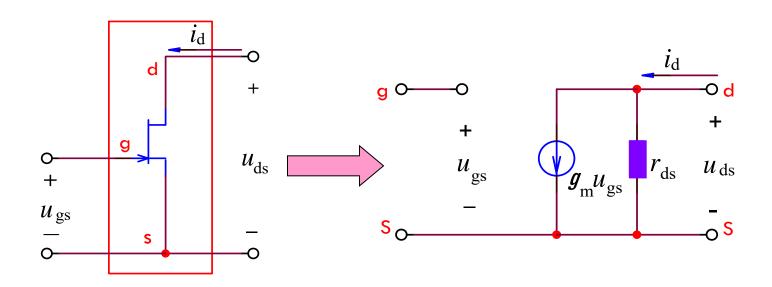
再求:
$$U_{DS} = V_{DD} - I_D (R_d + R)$$

该电路产生的栅源电压可正可负,所以适用于所有的场效应管电路。

二. 场效应管的交流小信号模型



与双极型晶体管一样,场效应管也是一种非线性器件,在交流小信号情况下,也可以由它的线性等效电路—交流小信号模型来代替。

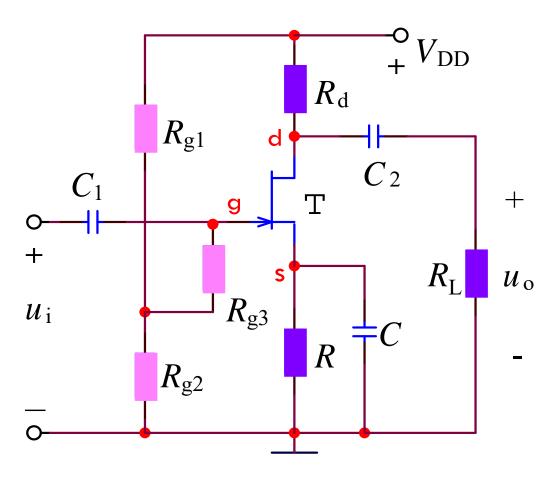


其中: $g_{\mathbf{m}}u_{\mathbf{gs}}$ 是压控电流源,它体现了输入电压对输出电流的控制作用。称为低频跨导。

 r_{ds} 为输出电阻,类似于双极型晶体管的 r_{ce} 。

三. 场效应管放大电路

1.共源放大电路



分析:

- (1) 画出共源放大电路的交流小信号等效电路。
- (2) 求电压放大倍数

$$u_{\rm i} = u_{\rm gs}$$
 $u_{\rm os} = -g_{\rm m}u_{\rm gs}(R_{\rm d} /\!/ R_{\rm L})$

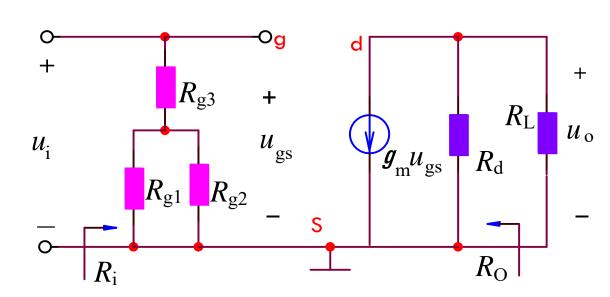
则
$$A_{\rm u} = \frac{u_{\rm o}}{u_{\rm i}} = -g_{\rm m}(R_{\rm d} /\!/ R_{\rm L})$$

(3) 求输入电阻

$$R_{\rm i} \approx R_{\rm g3} + (R_{\rm g1} // R_{\rm g2})$$

(4) 求输出电阻

$$R_{\rm o} \approx R_{\rm d}$$



2.共漏放大电路

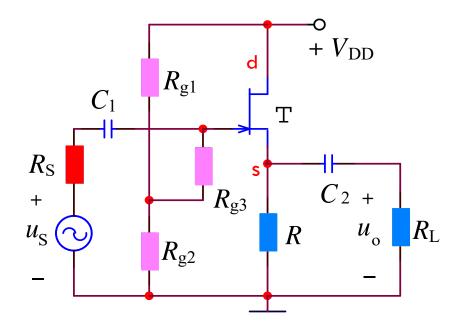
分析:

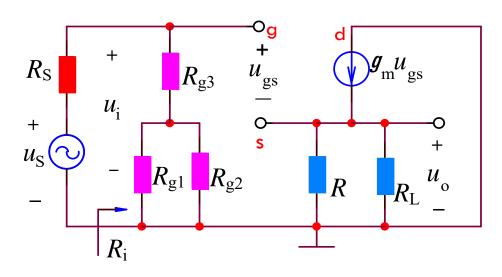
- (1) 画交流小信号等效电路。
- (2) 电压放大倍数

得
$$A_{\rm u} = \frac{u_{\rm o}}{u_{\rm i}} = \frac{g_{\rm m}(R/\!/R_{\rm L})}{1 + g_{\rm m}(R/\!/R_{\rm L})}$$
≈ 1

(3) 输入电阻

$$R_{\rm i} \approx R_{\rm g3} + (R_{\rm g1} // R_{\rm g2})$$



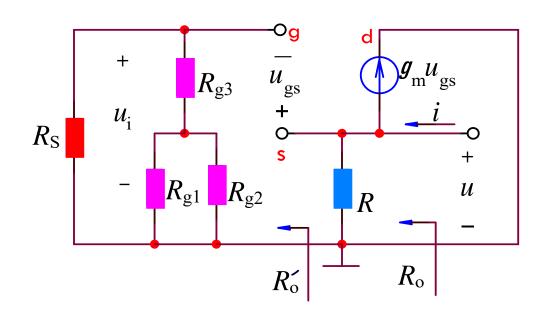


(4)输出电阻

由图有
$$i = i_R + g_m u_{gs} = \frac{u}{R} + g_m u_{gs}$$

$$u_{gs} = u_o$$

所以
$$R_0 = \frac{u}{i} = \frac{1}{\frac{1}{R} + g_m} = R / / \frac{1}{g_m}$$



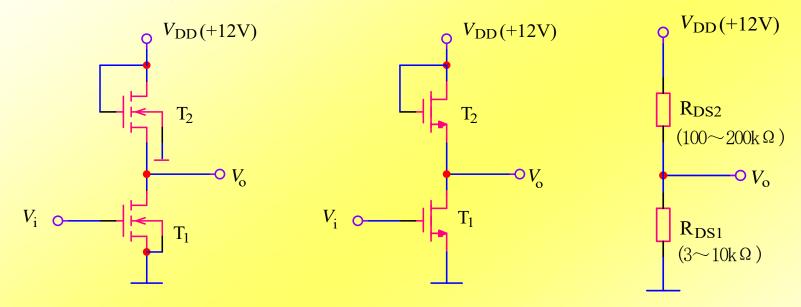
小结

- 1. FET分为JFET和MOSFET两种,工作时只有一种载流子参与导电,因此称为单极性型晶体管。FET是一种压控电流型器件,改变其栅源电压就可以改变其漏极电流。
- 2. FET放大器的偏置电路与BJT放大器不同,主要有自偏压式和分压式两种。
- 3. FET放大电路也有三种组态: 共源、共漏和共栅。 电路的动态分析需首先利用FET的交流模型建立电路的交流等效电路, 然后再进行计算, 求出电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等量。

2.3 **MOS**逻辑门电路

一、NMOS门电路

1. NMOS非门



逻辑关系:(设两管的开启电压为 $V_{T1}=V_{T2}=4V$,且 $g_{m1}>>g_{m2}$) (1) 当输入V.为高电平8V时, T_1 导通, T_2 也导通。因为 $g_{m1}>>g_{m2}$,所以两管的导通电阻 $R_{DS1}<< R_{DS2}$,输出电压为:

$$V_{\mathrm{OL}} = \frac{R_{\mathrm{DS1}}}{R_{\mathrm{DS1}} + R_{\mathrm{DS2}}} V_{\mathrm{DD}} \leq 1 \mathrm{V}$$
 所以输出为低电平。

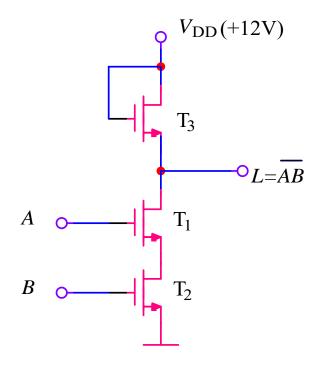
(2) 当输入 V_i 为低电平0V时,

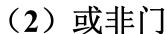
 T_1 截止, T_2 导通。所以输出电压为 $V_{OH} = V_{DD} - V_T = 8V$,即输出为高电平。

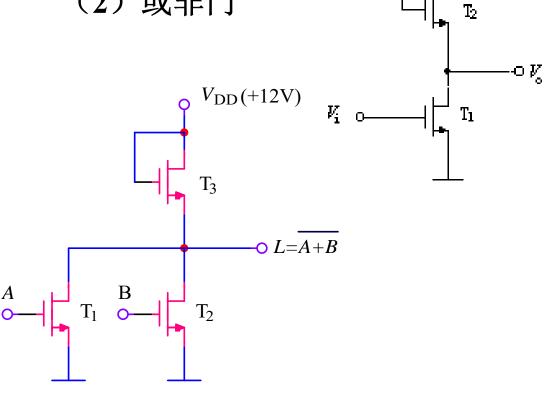
所以电路实现了非逻辑。

2. NMOS门电路

(1) 与非门



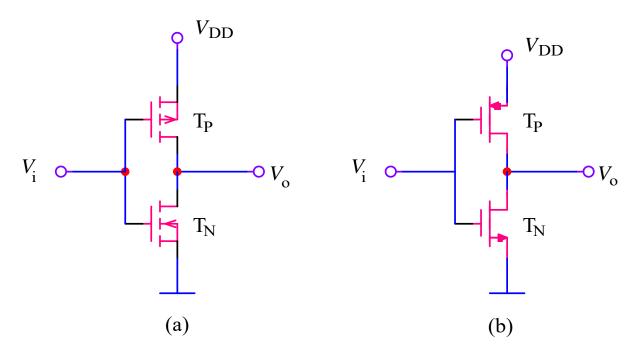




 $V_{DD}(+12V)$

二、CMOS非门

CMOS逻辑门电路是由N沟道MOSFET和P沟道MOSFET互补而成。



1. 逻辑关系:

(设
$$V_{DD}$$
> (V_{TN} + $|V_{TP}|$),且 V_{TN} = $|V_{TP}|$)

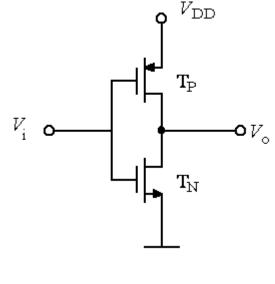
- (1) 当 V_i =0V时, T_N 截止, T_p 导通。输出 $V_o \approx V_{DD}$ 。
- (2) 当 $V_i = V_{DD}$ 时, T_N 导通, T_P 截止,输出 $V_O \approx 0V$ 。

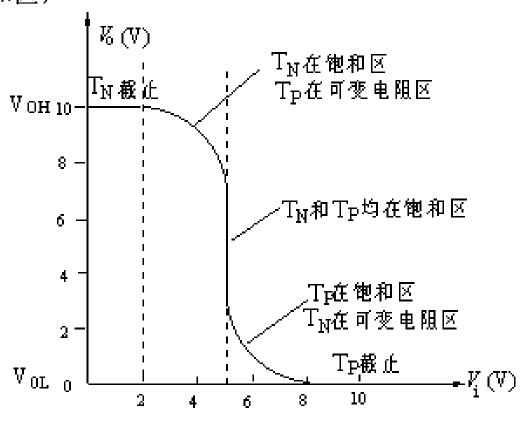
2. 电压传输特性: (设: V_{DD} =10V, V_{TN} =| V_{TP} |=2V)

- (1) 当 V_i <2V, T_N 截止, T_p 导通,输出 $V_o \approx V_{DD}$ =10V。
- (2) 当2 $\mathbf{V} < \mathbf{V}_i < 5\mathbf{V}$, \mathbf{T}_N 工作在饱和区, \mathbf{T}_p 工作在可变电阻区。
- (3) 当 $\mathbf{V_i}$ =5 \mathbf{V} ,两管都工作在饱和区, $\mathbf{V_o}$ =($\mathbf{V_{DD}}/2$)=5 \mathbf{V} 。
- (4) 当5**V**<**V**_i<8**V**, **T**_p工作在饱和区, **T**_N工作在可变电阻区。
- (5) 当V_i>8V, T_p截止, T_N导通,输出V_o=0V。 可见:

CMOS门电路的阈值电压

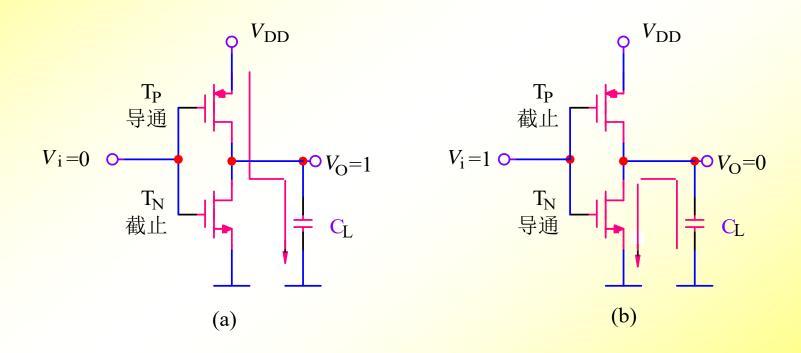
 $V_{\rm th} = V_{\rm DD}/2$





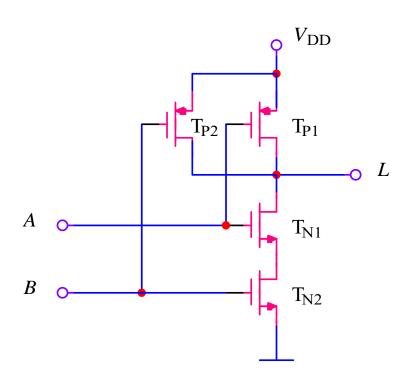
3. 工作速度

由于CMOS非门电路工作时总有一个管子导通,所以当带电容负载时,给电容充电和放电都比较快。CMOS非门的平均传输延迟时间约为10ns。

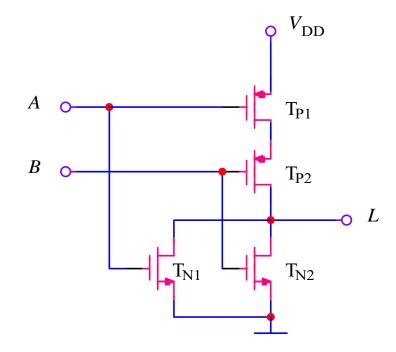


三、其他的CMOS门电路

- 1. CMOS与非门和或非门电路
 - (1) 与非门



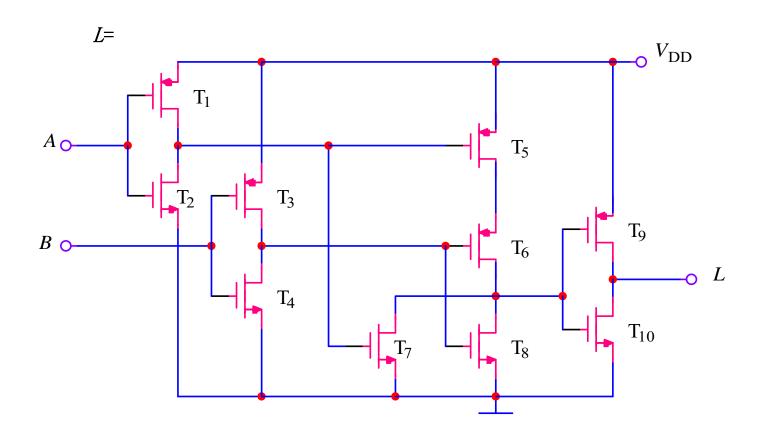
• (2) 或非门



(3) 带缓冲级的门电路

为了稳定输出高低电平,可在输入输出端分别加反相器作缓冲级。下图所示为带缓冲级

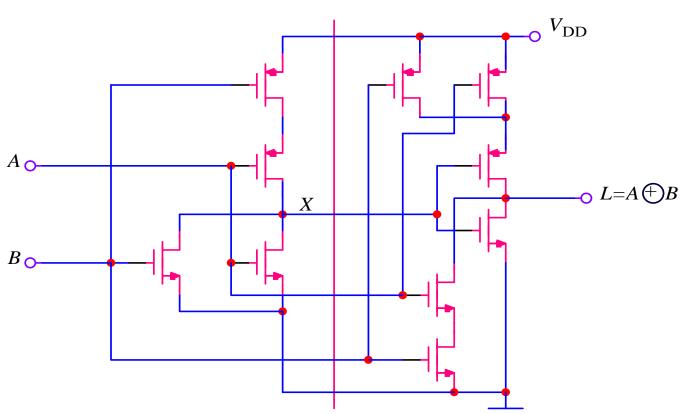
的二输入端与非门电路。
$$\overline{A} + B = \overline{A} \cdot B$$



2. CMOS异或门电路

由两级组成,前级为或非门,输出为 $X = \overline{A + B}$ 后级为与或非门,经过逻辑变换,可得:

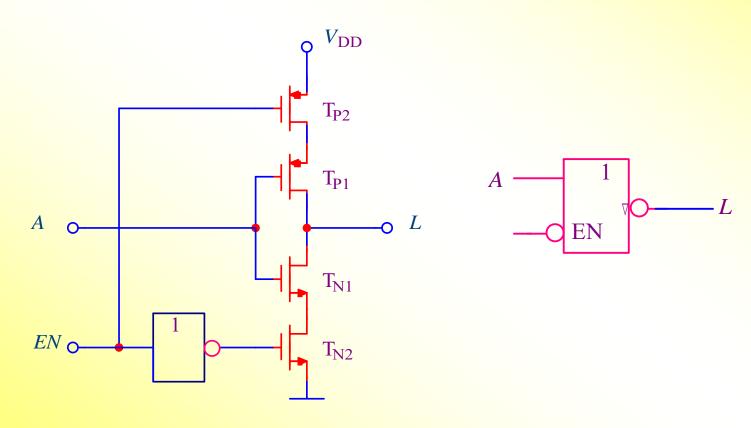
$$L = \overline{A \cdot B + X} = \overline{A \cdot B + \overline{A + B}} = \overline{A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}} = A \oplus B$$



3. CMOS三态门

工作原理:

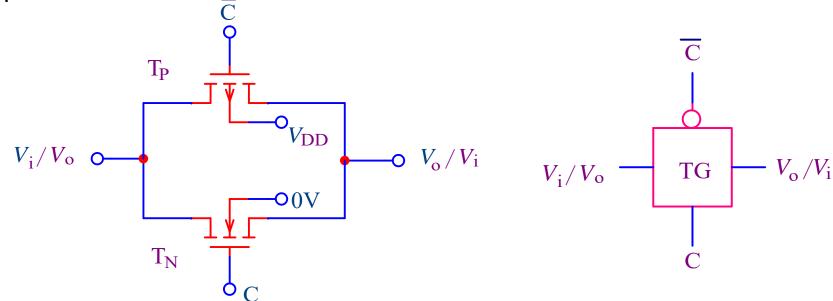
当EN=0时, \mathbf{T}_{P2} 和 \mathbf{T}_{N2} 同时导通,为正常的非门,输出 $L=\overline{A}$ 当EN=1时, \mathbf{T}_{P2} 和 \mathbf{T}_{N2} 同时截止,输出为高阻状态。 所以,这是一个低电平有效的三态门。



4. CMOS传输门

工作原理: (设两管的开启电压 $V_{TN}=|V_{TP}|$)

- (1) 当C接高电平 V_{DD} ,C接低电平0V时,若 V_i 在0V~ V_{DD} 的范围变化,至少有一管导通,相当于一闭合开关,将输入传到输出,即 V_o = V_i 。
- (2) 当C接低电平0V, 接高电平 V_{DD} , V_i 在0V $\sim V_{DD}$ 的范围变化时, T_N 和 T_p 都截止,输出呈高阻状态,相当于开关断开。



四、CMOS逻辑门电路的系列及主要参数

- 1. CMOS逻辑门电路的系列
 - (1) 基本的CMOS—4000系列。
 - (2) 高速的CMOS—HC系列。
 - (3)与TTL兼容的高速CMOS—HCT系列。
- 2. CMOS逻辑门电路主要参数的特点
- (1) $V_{OH \text{ (min)}} = 0.9 V_{DD}$; $V_{OL \text{ (max)}} = 0.01 V_{DD}$ 。 所以CMOS门电路的逻辑摆幅(即高低电平之差)较大。
- (2) 阈值电压 V_{th} 约为 $V_{DD}/2$ 。
- (3) **CMOS**非门的关门电平 V_{OFF} 为0.45 V_{DD} ,开门电平 V_{ON} 为0.55 V_{DD} 。因此,其高、低电平噪声容限均达0.45 V_{DD} 。
- (4) CMOS电路的功耗很小,一般小于1 mW/门;
- (5) 因CMOS电路有极高的输入阻抗,故其扇出系数很大,可达50。